



Technische Möglichkeiten		
	Standard	Spezial
Maximalgröße der LP	1000*600 mm	1500*600 mm (nur 1- oder 2-seitige PCB) 420*330 mm (HAL bleifrei) auf Anfrage
Maximale Lagenanzahl	64	auf Anfrage
Basismaterialien	FR4 Tg=135 °C, FR4 High CTI 600 Thermal Clad Halogenfrei Teflon Keramik Rogers	auf Anfrage
Dicke 1- und 2-Lagen PCB	0,2 – 8,0 mm	auf Anfrage
Multilayer	0,2 – 8,0 mm	auf Anfrage
Dickentoleranz Multilayer	+/-10 %	
Cu - Innenlagen	18 - 400 µ	Dickkupfer bis 1050 µ
Cu - Aussenlagen	18 - 400 µ	auf Anfrage
Cu - in Bohrung	>20 µ	
Aspect ratio		
TPH Aspect ratio	>=1:10	auf Anfrage
Blind via	>=1:1	auf Anfrage
Bohrloch		
Minimaler Fräsedurchmesser	0,10 mm	
Toleranz der metallisierten Bohrung	0,15 mm (-0,05/+0,10 mm)	+/-0,03 mm
Offset-Loch		
Routing		
Minimaler Fräsedurchmesser	1,0 mm	0,60 mm
Offset-Leitung	+/-0,20 mm	+/-0,10 mm
Ritzen		
Offset-Ritzen	+/-0,20 mm	
Layout		
Min. Leiterbahnbreite	100 µ	75 µ
Min. Leiterbahnabstand	100 µ	75 µ

Technologie		
Buried via	Ja	
Blind via	Ja	
Blind via - micro	Ja	
Buried via - micro	Ja	
Plugged via	Ja	
Lötstopplack (nichtleitend)		
Kupferfüllung (leitend)		
Einpresstechnik	Ja	
Lötstopplack und Druck		
Farbe	Beliebig	
Mindestdicke	Auf Anfrage, wenn nötig	
Druck – Farbe	Beliebig	
Mindestdicke	200 µ	100 µ
Oberfläche		
HAL – bleifrei	Ja	
HAL – bleihaltig	Ja	
Ni/Au – galvanisch	Ja	
Ni/Au – Immersion	Ja	
Sn – chemisch	Ja	
Steckervergoldung / Hartgold	Ja	
OSP	Ja	